

| | | | | |
|---|------------|---------------------------|---|-------------------|
| NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 | | DOCUMENT NO. : Q3-NL04 | TITLE : 設備作業標準 (SE-030 複合薄膜多腔體濺鍍系統) | |
| ISSUE DATE | 2021-04-15 | REVISION | 1.1 | PAGE 第 1 / 2 頁 |

一、目的：

定義複合薄膜多腔體濺鍍系統 (Cluster RF Sputter) 作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用於複合薄膜多腔體濺鍍系統 (Cluster RF Sputter)。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過複合薄膜多腔體濺鍍系統 (Cluster RF Sputter) 考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

五、相關文件：

無。

六、標準作業程序：

1. MES 控制系統開啟設備
2. 登入機台密碼：帳號 user；密碼 user。
3. 進入【Alarm】確認是否有異常訊息。
4. 進入【Control】點選『 L-Auto pumping OFF』後，按下『 Vent 』。
5. 腔體破真空完成後，放入試片。
6. 按下『 L-Auto pumping ON』。
7. 按下『 Transfer』，點選傳送至製程腔體。
8. 選取製程腔體 List，『 S1 List』或『 S2 List』，
9. 按下 Process 後，選取製程參數。
10. 製程結束後，按下『 Transfer』，點選傳送回 Load Lock。
11. 腔體破真空完成後，取回試片，並將 Load Lock 抽真空。
12. MES 控制系統 關閉設備。

七、應用表單及附件：

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------|---|------|-----------|
| NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 | | DOCUMENT NO. : Q3-NL04 | TITLE : 設備作業標準 (SE-030 複合薄膜多腔體濺鍍系統) | | |
| ISSUE DATE | 2021-04-15 | REVISION | 1.1 | PAGE | 第 2 / 2 頁 |

1. Q4-NL02 設備管理卡
 2. Q4-NL03 設備考核表
 3. Q4-NL04 設備點檢表
 4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單
-